

# 연수 제안서

연구 분야	차세대 반도체소재 및 나노소재
연구 과제명	층상구조 자성체를 활용한 스핀소자
연수 제안 업무	나노소재 및 이를 활용한 반도체 기술 개발
<div>연수기간</div> <div>2021.08.01. ~ 2024.07.31</div> <div>연수 내용</div> <div><div>1. 차세대 반도체 기술 개발</div><div>나노소재, 이차원물질, 위상물질 등 차세대 반도체 소재를 활용하여 초저전력 전자소자를 구현함. 전자소자의 효율적 구동을 위한 소재 최적화 기술, 공정 기술 등을 개발함.</div><div>2. 나노소재 기술 개발</div><div>계면/표면 스핀 수송 효율이 높게 유지되는 나노소재와 나노소자를 개발하고, 계면 엔지니어링으로 나타나는 신물성을 탐색함. 스핀 수송 특성에 큰 영향을 미치는 소재의 기초 물성 분석을 통해 스핀소자에 최적화된 나노소재(이차원물질 접합구조, 자성박막 등)를 개발함.</div></div>	
소속 부 서 : 스핀융합연구단	
연수 책임자 : 최 준 우	